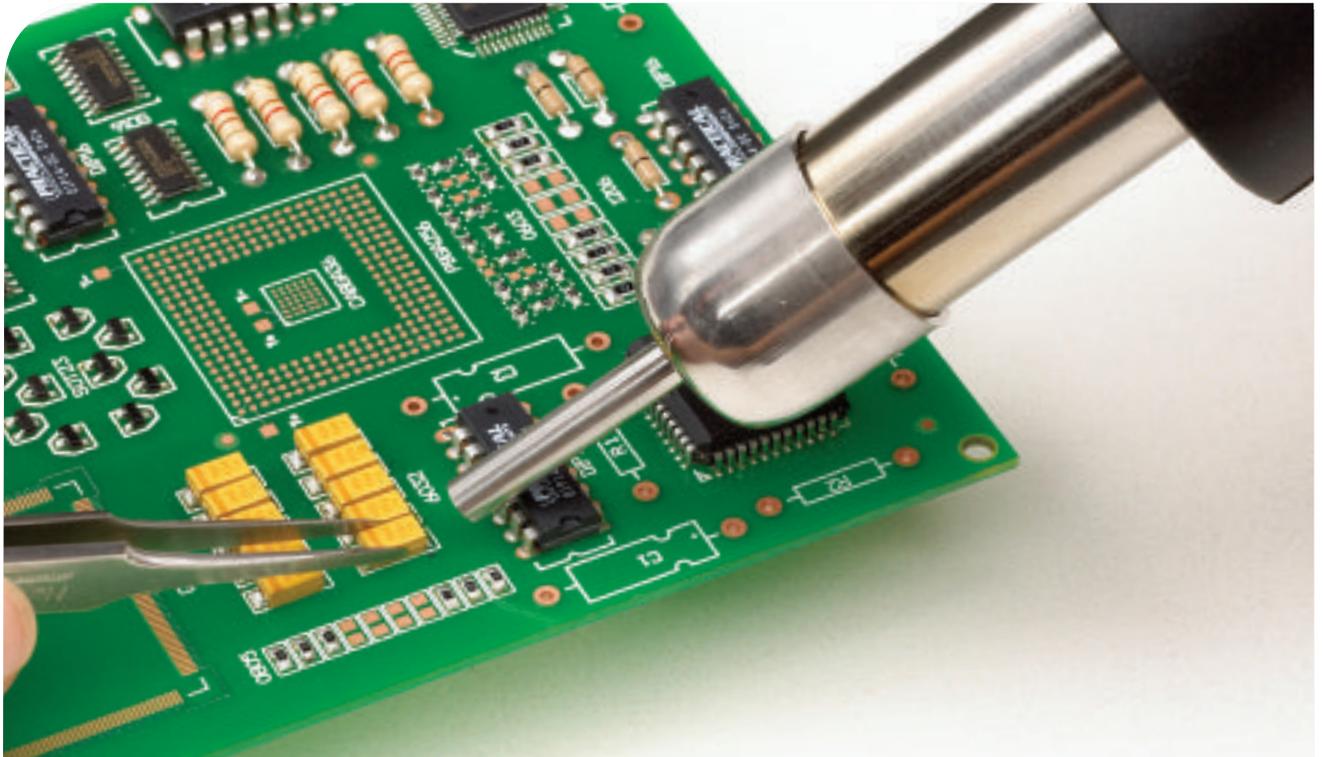


Heißluftsystem HCT-900



Vielseitiges Heißluftsystem für Löt- und Entlötanwendungen

Das Heißluftsystem HCT-900 ist eine preiswerte, vielseitige Rework-Lösung für zahlreiche Produktions- und Nacharbeitsanwendungen. Die kompakte Konstruktion beinhaltet eine leistungsstarke Pumpe und die analogen Steuerungen für Luftstrom und Heizelement. Der geschlossene Regelkreis stellt sicher, dass die eingestellte Solltemperatur unabhängig von Schwankungen im Luftstrom erreicht und gehalten wird.

Das HCT-900 kann zum Entfernen und für den Austausch von elektronischen Komponenten, einschließlich bleifreier Bauteile von 0201-Komponenten bis 304-Pin-QFPs eingesetzt werden. Es ist ebenfalls geeignet für die Nacharbeit von bedrahteten Bauelementen, wie zum Beispiel Buchsen und Steckern. Lotkurzschlüsse und Lotspritzer lassen sich schnell und effizient unter Zuhilfenahme von Entlötlitze und Flussmittel entfernen. Darüber hinaus ist ein Einsatz bei Kunststoffanwendungen, wie zum Beispiel das Aufbringen von Schrumpfschlauch auf Drähte oder die Bildung von Kunststoffnieten, möglich.

Die stufenlos regelbare, geräuscharme Pumpe (unter 46 dBA) sorgt auch bei komplexen Anwendungen für eine genaue Steuerung des Luftstromes. Nach dem Abschalten des Gerätes sorgt die Funktion "power off" dafür, dass weiterhin für einige Sekunden Luft durch das Heizelement im Handstück geblasen wird. Hierdurch wird ein Überhitzen des Heizelementes verhindert.

Das HCT-900 entspricht den ESD-Vorschriften.



Art.-Nr.	Beschreibung
HCT-900-21	Heißluftsystem, 230 VAC
HCT-HE-21	Ersatz-Heizelement, 230 VAC

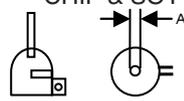
Düsenauswahl

Zum Lieferumfang des HCT-900 gehört standardmäßig die Düse H-D50 (Ø 5,0 mm).

Darüber hinaus stehen zwei Rework-

Düsenätze für spezifische Anwendungen zur Verfügung.

Art.-Nr.	Beschreibung
NZKT-1	Düsenatz für Chip-Widerstände, SOIC- und TSOP-Komponenten • H-D25 • H-SL16 • H-SL28 • H-SOJ40 • H-TS48
NZKT-2	Düsenatz für PLCC-, QFP- und BQFP-Komponenten • H-P20 • H-P44 • H-P84 • H-Q1420 • H-Q2626

PLCC, BQFP, QFP	Art.-Nr.	Chiptyp	A mm	B mm
	H-P20	PLCC-20	11,9	11,9
	H-P28	PLCC-28	14,5	14,5
	H-P32	PLCC-32	16,9	14,3
	H-P44	PLCC-44	19,5	19,5
	H-P52	PLCC-52	22,0	22,1
	H-P68	PLCC-68	27,0	27,2
	H-P84	PLCC-84	32,4	32,4
	H-Q07	QFP-48	8,4	8,4
	H-Q10	QFP-44	13,4	13,4
	H-Q14	QFP-52,80	17,3	17,3
	H-Q1420	QFP-64,80,100	23,4	18,1
	H-Q28	QFP-120,128,144,160	31,2	31,2
	H-BQ23	BQFP-100	22,4	22,4
	H-Q3232	QFP-240	34,5	34,5
	H-BQ38	BQFP-196	37,7	37,7
	H-Q2626	QFP-208	29,8	29,8
SOIC, TSOP	Art.-Nr.	Chiptyp	A mm	B mm
	H-S16	SOIC 14,16	6,8	10,2
	H-SL16	SOL 14,16	10,6	10,8
	H-SL20	SOL 20,20J	10,6	13,3
	H-SL24	SOL 24,24J	10,6	15,9
	H-SL28	SOL 28	10,6	18,4
	H-SL44	SOL 44	16,0	27,9
	H-SOJ32	SOJ 32	13,5	20,6
	H-SOJ40	SOJ 40	13,5	25,4
	H-TS24	TSOP 20-24	17,0	7,1
	H-TS32	TSOP 28-32	21,0	9,1
	H-TS40	TSOP 40	21,0	10,8
	H-TS48	TSOP 48	21,0	13,3
	H-TSW24	TSOP 20-24	10,2	18,4
	H-TSW44	TSOP 24-28/40-44	12,7	19,8
CHIP & SOT	Art.-Nr.	Ø A (mm)		
	H-D25	2,5		
	H-D50	5,0		
	H-D120	12,0		

Technische Daten HCT-900

Eingangsspannung	230 VAC
Leistungsaufnahme	320 Watt max.
Pumpe	Membran
Luftstrom	6 - 25 l/min
Temperaturbereich	100 °C - 500 °C
Abmessungen	170 x 210 x 140 mm
Geräuschpegel	< 46 dBA
Oberflächenwiderstand	System: 10 ⁵ Ω - 10 ⁶ Ω, Handstück & Zuleitung : 10 ⁷ Ω - 10 ¹¹ Ω
Gewicht	4,7 kg
Zertifizierung / Zulassung	cTUVus, CE

Technische Änderungen vorbehalten.